



導電銀漿 GA-2038 技術資料

GA-2038 高效能導電銀漿-適用於薄膜按鍵開關與軟性電路板

簡介

GA-2038 是高效能低溫烘烤型的網版印刷導電銀漿，漿料在 120 °C 烘烤 30 分鐘以上時，可獲得優異之電氣及物理特性，能提供良好的彎折性、附著性、硬度與阻抗值。適合使用本漿料之行業涵蓋薄膜按鍵開關製造、軟性電路板印刷與觸控螢幕相關業界。

漿料特性

- 低電阻
- 硬度佳
- 附著性佳
- 印刷性好
- 繞折性佳

一般物性⁽¹⁾

特 性	檢驗結果	檢驗方式
外觀	銀色	目測
固含量	71±2 (wt%)	150 °C /1 h
附著性	100/100	3M 膠帶#600
鉛筆硬度	2H	ASTM D3363
表面電阻 ⁽²⁾	≤16 mΩ/□/mil	ASTM D257-78
黏度	25,000±5,000 (cps)	Viscometer ⁽³⁾
保存條件與期間	6 個月(5°C~25°C，乾燥陰暗處)	

漿料測試數據 (僅供參考)

烘烤條件	表面電阻	硬 度
Oven 120°C/30 min	~15 mΩ/□/mil.	2H

建議使用方法

漿料攪拌時間	10~15(min) ; speed : 200~300(rpm)
網版	Polyester, Stainless Steel
建議網版網目	200~300 (Mesh)
乳化劑厚度	8 ~12 (μm)
稀釋劑	1 %~3 % of Total Weight (if needed) ⁽⁴⁾
洗版劑	Cyclohexanone or other Suitable solvents

Notes:

- (1) Typical properties that are not intended to used as specification limits
- (2) 烘烤溫度：120 °C/30 min
- (3) Brookfield RVT #5 spindle at 10 rpm，攪拌溫度 24.5°C~25.5°C
- (4) 如需稀釋使用，請聯絡供應廠商。
- (5) 網印前請先根據上面建議使用方法之漿料攪拌時間規定。

包裝

瓶裝重量	1 kg
------	------

※本資料所提供之數據係依本公司實驗室測試而得，並相信是正確的。本公司僅針對本產品之特性做出廠測試，保證產品品質穩定並符合本公司訂定之產品規範。其於各產業之應用，由於產業別眾多且測試條件不一，無法分別於本公司實驗室中做完整之測試，應由個別廠商於使用前自行審慎測試，評估其於該產業用途之適用性，並自行負擔使用本產品所導致之責任與風險。